

受付 番号	プログラム 番号	氏名	勤務先	発表題目 和文
1	78	渡邊 文男	株式会社ヨコオ	Ag-Cu-Pd合金の微細組織と機械的特性の関係
2	10	金黒 秀平	大阪大学 接合科学研究所	パワーサイクル試験におけるダイボンド部の劣化挙動
3	1	坂口 智紀	鹿児島大学大学院	4点曲げを用いたパワーモジュール用アルミワイヤボンドの疲労試験
4	79	釜塚 純	富山大学 大学院	樹脂リテーナにCNFを添加した際の耐磨耗性、耐久性の評価
5	22	佐藤 敏一	(株)豊田中央研究所	Cuナノ粒子とZn粉末を用いたパワー半導体素子実装向けCu-Zn合金接合
6	57	濱田 雅和	三菱電機株式会社	ワイヤボンディングの接合中における接合界面の温度に関する研究
7	19	三好 健太郎	大陽日酸株式会社	銅ナノ粒子を用いた接合シートの開発
8	2	葉山 裕	北九州市環境エレクトロニクス研究所	パワーモジュール・ワイヤ接合部の強度信頼性評価
9	63	熊本 光希	群馬大学大学院	Fe/Al異材マイクロ接合部の接合強度に及ぼす金属間化合物層の影響
10	56	田中 拓真	群馬大学大学院	Alの固相拡散接合及ぼす電解水水溶液による表面処理の影響
11	32	鈴木 陸	群馬大学大学院	ビスフェノールF型エポキシ樹脂/銅接着界面の劣化寿命に及ぼす時効条件の影響
12	58	橋本 晏奈	群馬大学大学院	電析Ni-P非晶質合金被膜を利用したステンレス鋼の接合
13	61	小幡 佳弘	マレリ株式会社	酸素イオン伝導体を用いた陰極接合の発見と金属材料接合への適用
14	41	大橋 直倫	パナソニック株式会社	超低温接合はんだペースト材料の開発
15	65	新井 俊悟	東京理科大学	平準化生産における品種毎のエネルギー原単位の定式化
16	52	佐藤 牧子	ナミックス株式会社	LIB負極集電体の表面処理による接触角制御とLIB特性への影響
17	20	三並 淳一郎	株式会社大阪ソーダ	新規低温焼結性銀粒子の開発とその応用
18	60	高桑 啓	三菱マテリアル株式会社	非Ag系接合材を用いたCu/Si3N4接合技術の開発
19	33	竹内 暁人	東京大学大学院	接合界面における光学応答を利用した 成形接合の非破壊評価
20	77	井口 洋二	東京工業大学	微小体配列のための回転を用いた球面脱離時の把持力解析
21	40	池田 拓磨	パナソニック株式会社	マイクロ波電力伝送用フレキシブルアンテナの検討
22	76	松本 圭司	日本アイ・ピー・エム	ニードルタイプ・電気化学センサーにおける参照電極の再生方法
23	43	山本 輝彦	白光株式会社	はんだ付けにおけるはんだ及びフラックス飛び散り試験と対策
24	69	高原 渉	大阪大学	分子動力学法によるアルミニウムナノ液滴内圧力の考察
25	50	内田 智之	株式会社東レリサーチセンター	ラマン分光法を用いたGaN HEMTのはんだ接合応力の評価
26	3	梶 勇輔	三菱電機株式会社	高温動作パワーモジュール向けエポキシ樹脂封止技術の開発
27	44	斎藤 彰	株式会社村田製作所	外部電極形状がSnウィスカの成長に及ぼす影響
28	14	森下 真衣	大阪大学大学院工学研究科	基板材料がSn-Ag-Cuはんだ接合部の熱疲労特性に与える影響
29	9	杉本 大成	芝浦工業大学大学院	Sn-Ag-Cuはんだ接合部の鉛直方向破壊機構と有限要素法解析を用いたその機構の再現の検討
30	15	師岡 弘一	芝浦工業大学大学院	使用中のクリープ劣化を考慮したBGAパッケージはんだ接合部の熱疲労寿命予測
31	4	細谷 康佑	芝浦工業大学大学院	パワーサイクル試験におけるSn-Ag系ダイアタッチ接合部の破壊機構とその支配因子
32	38	大野 堅太	芝浦工業大学大学院	半導体用層間絶縁膜と銅配線層の剥離靱性評価
33	62	中本 将嗣	大阪大学	レーザー照射Cu表面微細クレバスの細い経路上における液体Sn,Biの特異拡張濡れ
34	11	花田 隆一郎	三菱電機株式会社先端技術総合研究所	純Snはんだ接合部の鉛直方向破壊率と接合部厚との関係
36	12	岡田 徹	富士通アドバンステクノロジー	超高速温度可変装置を用いたはんだ接合部寿命予測に関する考察
37	45	市川 龍	千住金属工業株式会社	SnBiはんだ実装、BGAのハイブリッド実装における影響因子
38	5	佐藤 香織	三菱電機株式会社	コールドスプレー法によるパワーモジュール基板用導体膜の特性
39	74	三輪 慶人	早稲田大学	ソフトリソグラフィ技術を用いてマイクロパターン化した魚うるこコラーゲン足場材付き培養口腔粘膜の作製
40	21	穴井 圭	三井金属鉱業株式会社	加圧焼結プロセスを用いた銅シンター材の接合特性
41	8	正元 祐次	株式会社ADEKA	パワーモジュール用金属エッチング剤の開発
42	24	庄子 正剛	大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構	プリントドワイヤーボンディング技術の開発
43	36	岩井 貴雅	三菱電機(株)	レーザー加工を用いたモールド樹脂の新規密着性評価手法
45	68	篠原 勇人	群馬大学	ベリリウム銅11合金の固相接合強度に及ぼすギ酸塩被膜付与の影響
46	49	小島 知高	三菱電機株式会社 静岡製作所	流体シミュレーションを活用したフローはんだ付け品質の向上
47	42	三ツ井 恒平	群馬大学	Sn-Sb-Ag系合金の高温疲労特性に及ぼすNiおよびGe添加の影響
48	39	山田 紘右	早稲田大学	原子層堆積法により形成した薄膜金属中間層を用いた低温Cu-Cu疑似直接接合法の開発
49	59	金澤 賢司	国立研究開発法人 産業技術総合研究所	マイクロ波加熱を用いた実装における電極パッド形状の検討
50	16	矢尾板 明子	株式会社東芝	はんだ材の線形粘弾性定式化による接合部寿命解析の高速化
51	46	木村 真之介	大阪大学大学院	はんだバリア層の合金化および多層化による拡散抑制効果の向上
52	70	山際 大貴	大阪大学大学院	サブミクロン銅粒子を用いた無加圧接合における焼結プロセスの検討
53	31	廣瀬 真一	株式会社富士通研究所	配向カーボンナノチューブ束を用いた高熱伝導放熱シートの実現
54	29	小林 憲司	日本電気(株)	低圧冷媒を用いたデータセンター向け局所冷却システムの開発
55	30	西 剛伺	足利大学	マイクロプロセスパッケージ向けの新たなコンパクト熱モデル
56	80	山中 公博	中京大学	低温実装を実現する液体金属Gaの電気抵抗の温度特性
57	55	阿部 陽介	富士電機株式会社	1.2GPa級超高張力鋼の2パルススポット溶接
58	7	本間 秀和	奥野製薬工業株式会社	ビア底部の結晶連続性に対する無電解銅めっきプロセスの影響
59	66	森永 英二	大阪大学	混流生産における投入順序・部品搬送統合化計画の一効率的手法
60	75	岡田 啓	鳥取大学	生体深部体温計測のための細径針形状温度センサ
61	18	仙波 孝彬	株式会社村田製作所	結露サイクル試験を用いたAgのエレクトロケミカルマイグレーションの評価
62	67	植田 俊太	大阪大学	機械学習による製品特徴抽出の因果情報抽出による高精度化
63	47	吉田 圭佑	大阪大学大学院	V型溝を利用したソルダ粉末の溶融凝集およびぬれ性評価
64	17	石津 勝之	株式会社村田製作所	複合パワーサイクル試験による製品の弱点早期検出
65	51	中澤 史穂	群馬大学大学院理工学府	導電性接着剤のバインダ配合成分がフィラー間電気伝導特性発達挙動に及ぼす影響
66	35	南 尚吾	大阪大学	微細粒子を含有した低融点金属金属の架橋構造が導電性接着剤における熱伝導率に及ぼす影響の定量的評価
67	25	家永 隆史	紀州技研工業株式会社	インクジェット法によるナノ粒子を用いた積層構造物の形成技術と生産性
68	26	細野 雄太	群馬大学	ストレッチャブル導電性ペースト印刷配線の負荷一除荷過程での電気抵抗率変化の時間依存性
69	34	井上 雅博	群馬大学	導電性接着剤の化学的因子制御によるフィラー近傍の界面状態と導電性発達挙動の変化
70	27	井上 雅博	群馬大学	パルスNMR法を用いたコロイド中の粒子分散性評価
71	48	岡本 拓也	三菱電機株式会社	プリント配線板における反り挙動評価
72	53	佐藤 雄河	芝浦工業大学	有限要素法を用いた紫外線硬化性接着剤の硬化収縮解析
73	13	大崎 滉二	芝浦工業大学	無加圧焼結されたAgナノ粒子の疲労き裂進展特性におよぼす時効の影響
74	71	上島 稔	(株)ダイセル	ダイアタッチ向けAg-Si粉末焼結技術
76	72	Buße Dirk	budatec GmbH	水素雰囲気焼結-プロセスパラメーターの最適化
77	23	Alipour Leila	大阪大学	銀焼結接合ダイアタッチに適合する高耐熱無電解銀めっき Ni/Pd/Pt/Ag の検討
79	54	森山 悠佑	大阪大学大学院	コールドスプレー法を用いた基板表面への凹凸形成による樹脂-金属界面の強度改善